

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

## 沪士电子股份有限公司投资者活动记录表

编号：2026-0602-018

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他：_____
参与单位名称	国泰综合证券、泓达投资股份有限公司、敦美投资（参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）
时间	2026年6月2日 10:30-11:30
地点	公司会议室
形式	实地调研
公司接待 人员姓名	钱元君、王术梅
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>（一）公司经营策略及市场</p> <p>1、数据通讯市场</p> <p>AI 已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业化落地及全球化扩张的新阶段，大模型训练与推理需求双双迅速上升，AI 已成为数据中心基础设施的关键基石，大规模云数据中心向人工智能与高性能计算集群演变，促使全球主要云服务提供商（CSP）大幅增加资本支出，加速推动了 AI 服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为 PCB 行业带来了强劲的结构增长动能。</p> <p>相应的，近年来面向数据通讯应用领域 PCB 需求的爆发式增长，一方面大量同行纷纷调整战略，将资源向该领域倾斜，以图通过激进的资本开支与产能扩张切入市场并取得一定的市场份额，随着行业产能的持续扩张，新增产能的逐步落地，成熟技术平台的准入门槛将被摊薄，未来的竞争或将趋向同质化与白热化，利润空间或将面临结构性挤压；另一方面 PCB 日渐成为数据通讯应用领域高阶硬件的重要赋能者，其技术跃迁正逐步重构 PCB 行业的竞争边界与价值分布格局，行业或将呈现“入场者多、通关者少”的格局，并驱使高</p>

阶 PCB 产品市场加速向具备全球化产能协同与顶尖研发积淀的行业头部梯队集中，呈现明显的结构性分化。

面对复杂的行业变局，公司历来不盲从于以规模和价格为导向的同质化扩张，而是全面深化差异化产品竞争战略，恪守“技术优先”的发展方针。公司深知，唯有技术突破才能跨越周期。公司将研发端的技术前瞻性与制造端的大规模量产能力深度耦合，将优势资源倾斜于数据通讯应用领域高阶硬件所需的高附加值核心 PCB 产品，凭借卓越的创新能力和稳定可靠的品质口碑、国内和泰国的产能协同，与头部客户群体构筑深度的价值共同体，以期在激烈的市场重构中持续提升竞争力，在复杂多变的市场环境中锚定确定性，以求可持续高质量发展。

## 2、智能汽车市场

汽车 PCB 市场正处在中低端供给相对过剩、原材料价格上涨、整车价格竞争向产业链传导的复杂环境之中，整体呈现出规模持续增长、行业竞争加剧、需求结构升级、技术创新加速的鲜明特征。随着新能源汽车、电驱高压平台、高级驾驶辅助系统(ADAS)、智能座舱以及 SDV 持续推动汽车电子架构升级，整车电子模块正由分布式 ECU 加快向域控制、区域控制和中央计算架构演进，持续提升对多层板、高阶 HDI、高频高速、耐高压、耐高温、高集成度汽车 PCB 产品的需求，驱动汽车 PCB 延续中长期增长趋势。全球汽车 PCB 行业的竞争主线将围绕车规级可靠性、技术升级能力、平台化配套能力、全球交付能力以及精细化成本控制能力全面展开。公司依托长期技术积累和可靠品质，深化与客户在新能源车、ADAS、智能座舱、车联网等领域合作，加强关键技术研发与前期设计验证，持续优化产品和产能结构，以应对市场挑战。

### (二) 其他

1、保持战略定力，坚定不移地纵深推进差异化竞争战略。公司将以技术创新为引擎，持续加大研发投入，加大产线技改力度，不断提升产品技术含量，拓宽差异化护城河，在激烈的市场重构中抢占高价值先机。2026年初，公司公告在常州市金坛区投资设立全资子公司，搭建 CoWoP 等前沿技术与 mSAP 等先进工艺的孵化平台，构建“研发-中试-验证-应用”的闭环体系，布局光铜融合等下一代技术方向，系统提升产品的信号传输、电源分配及功能集成能力，待相关技术工艺验证成熟并具备产业化条件后，投建高密度光电集成线路板的规模化生产线。

	<p>2、全面加速数字化与 AI 赋能的智能制造体系升级，尝试构建数据驱动、全流程可追溯、AI 辅助决策的智慧运营底座，摸索将智造能力深度融入高阶 PCB 的复杂制程中，通过其强大的数据分析、预测能力和自动化技术，减少人工干预、改善生产过程，努力提升高阶 PCB 的工艺制程能力，优化设备运行，提升异常精准预警能力并降低报废率，识别节能机会，以更好的达成技术突破、极致效率、成本管控与卓越品质的平衡。</p> <p>3、全面统筹并稳步推进国内外产能的有序扩张与前瞻布局。</p> <p>（1）在国内兼顾短期效益与长期发展，一方面聚焦高阶 PCB 的瓶颈及关键制程，实施迭代升级与靶向性产能扩充，持续深挖现有厂区的高附加值产出潜力，另一方面，加快推进高端扩产项目的建设。基于对市场需求及其结构的预判，2026 年第一季度公司加速启动了系列产能扩充计划。扩产并非简单的规模复制，而是分阶段达成产能的升级式扩容，旨在提前卡位优质产能，以更好的满足头部客户群体的需求。</p> <p>（2）通过着力强化国内外各生产基地的资源协同效应，逐步构建起多维一体、梯次有序的国内外产能梯次矩阵，有效化解地缘政治与供应链重构的潜在风险，动态适配数据通讯与智能汽车等核心领域日益增长的市场需求，为公司长期高质量发展编织牢固的国内外生产供应网络。</p> <p>4、针对供应链可能出现的瓶颈，主动而且战略性的深化合作与协同创新机制。伴随高阶 PCB 向超低损耗树脂、超低轮廓铜箔（HVLP）及特种高性能玻纤布加速演进，严苛的工艺壁垒与良率瓶颈致使部分高端原材面临阶段性的产能受限，供应偏紧状态。公司在终端客户产品开发的极早期便全面介入，提前参与新一代高端材料的电性能验证与可靠性测试等，缩短材料认证周期，确保在供应紧张时获得优先配额保障；同时全面落实关键物料的战略安全库存，并加速推进多元化与本地化认证，减少原物料断供风险，强化具有韧性的供应链安全壁垒。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单	无